

KONTAKTIEREINHEIT, ABSENKEND | LANDING CONTACT UNIT



840-2L

Ausführung

- Aus einem Formteil gefertigt, dadurch besonders robust
- Kontaktlage nach ISO 8
- Rückseitige Anschlusspads in Reihe
- SMD- oder THT-Ausführung
- Ohne oder mit Fixierungszapfen
- Staub- oder waschdichter Endschalter

Optionen

- Schutz vor elektrostatischer Entladung
- Aufbohrschatz (840-2L Secure)

Hinweis

- Schleifende Ausführung: 840-2F

Abmessungen

55.5 x 35.5 x 6.3 mm

840-2L

Construction

- Made in one piece, thus especially sturdy
- ISO 8 contact locations
- Row of contact pads at rear
- SMD or THT design
- With or without fixing pivots
- Dustproof and washproof limit switch

Options

- Protection against electrostatic discharge (ESD)
- Anti-drill protection (840-2L Secure)

Note

- Friction contact design: 840-2F

Dimensions

55.5 x 35.5 x 6.3 mm

Chipkontakt Chipcontact	Kontaktierung Anzahl der Kontakte Kontaktierungsart Kontaktform Kontaktkraft Kontaktmaterial Kontaktoberfläche	according to ISO 7816 8 landing card ball radius > 0.8 mm 0.2 N to max. 0.6 N copper alloy Flash Gold over palladium over nickel	Contact location Number of contacts Contact system Contact style Contact force Contact material Plating
Allgemein General	Lebensdauer	500.000 operations (in clean office room). 1.5 Million operation's internal tested under laboratory conditions (without warranty of the manufacturer)	Life

Elektrische Kennwerte | Electrical characteristics

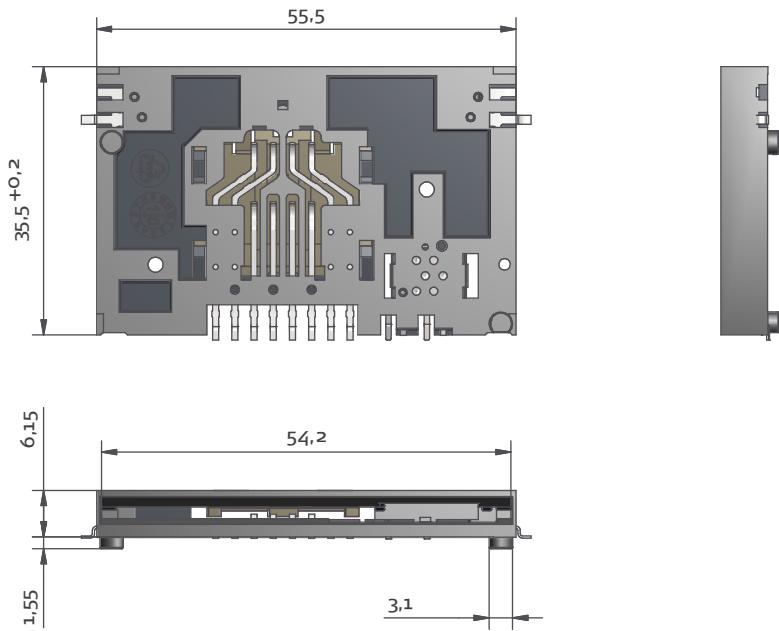
Kontakte Contacts	Durchgangswiderstand Isolationswiderstand Spannungsfestigkeit Strombelastbarkeit	< 200 mOhm > 1000 MOhm > 1000 V eff max. 1 A - min. 10 µA	Contact resistance Insulation resistance Voltage Current
Dichter Endschalter End switch	Schaltspannung Schaltstrom Schaltleistung Übergangswiderstand Isolationswiderstand	min. 20 mV max. 50 V min. 1 mA max. 300 mA max. 1 VA max. 400 mOhm min. 100 MOhm	Switching voltage Switching current Switch load Contact resistance Insulation resistance

Umgebungsbedingungen | Environmental conditions

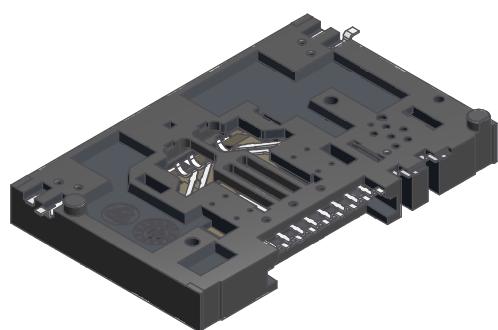
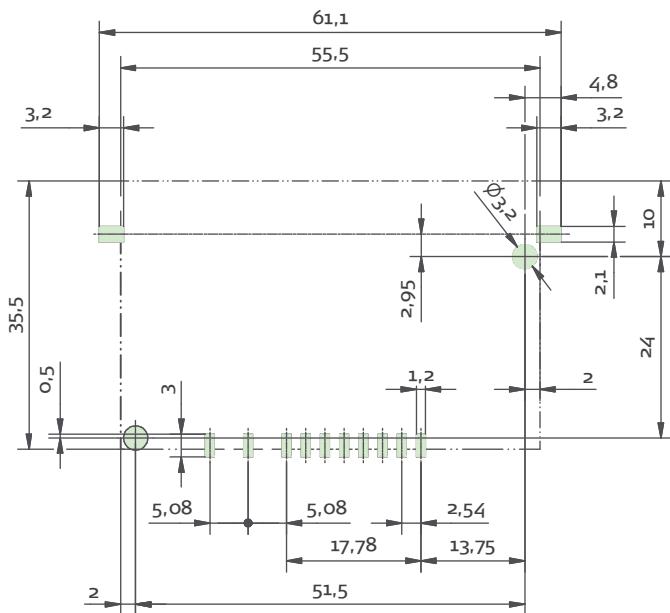
Prüfklasse IEC 68 / EN 60068 | Testclass acc. IEC 68 / EN 60068

Klimatische Bedingungen Climatic conditions EN 60721-3-3 (3K6)	Lagertemperatur Betriebstemperatur Luftfeuchtigkeit Luftdruck	- 40 °C ... + 85 °C - 40 °C ... + 70 °C 10 ... 100 % relative humidity not condensing 70 ... 106 kPa	Storage temperature Operating temperature Humidity Air pressure
Chemisch-aktive Stoffe Chemical active substance	EN 60721-3-3	(3C2)	EN 60721-3-3
Löten Soldering	Handlöten Wellenlöten Reflowlöten	max. 350°C / 2 sec. max. 260°C / 5 sec. according IPC JEDEC J-STD-020C	Manual soldering Wave soldering Reflow soldering

840-2L



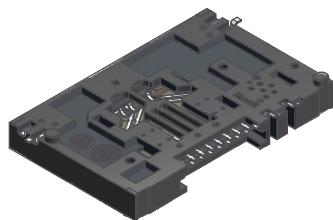
Leiterplattenbohrbild (Bauteilseite)
Soldering pad (component side)



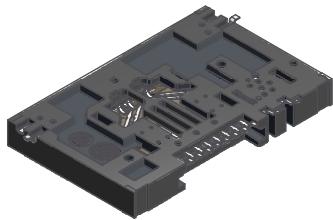
Ausführung version

3

Mit Fixierungszapfen
with fixation pivots

**4**

Ohne Fixierungszapfen
without fixation pivots



Bauform design

0

Ohne seitliche SMD Löt-Pads
without solder tabs

**1**

Mit je 1x Seitliche SMD Löt Pads
with each 1x solder tabs

**2**

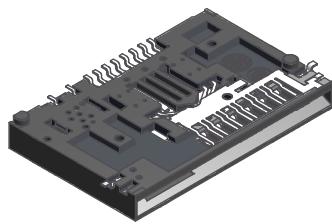
Mit je 2x Seitliche SMD Löt Pads
with each 2x solder tabs

**4**

Mit je 1x Seitliche SMD Löt Pads J-hock
with each 1x solder tabs J-hock

**5**

Mit je 1x Seitliche SMD Löt Pads + ESD-Blech
with each 2x solder tabs + ESD-metalsheet



Sicherer Leser secure Reader

0

Ohne Abdeckhaube
without contact protection

1

Mit Abdeckhaube PCI POS
nur mit Option "Bauform" 1
with contact protection PCI POS
only with option "design" 1

Bestell-Schlüssel ordering code

8 4 0 - 2 L 1 2 □ 3 1 2 □ 0 □

Ausführung _____
version _____

Sicherer Leser _____
secure Reader _____

Bauform _____
design _____